

株式会社東京精密(証券コード7729) Web説明会

2026/03/30

株式会社東京精密

代表取締役会長 吉田 均

- 将来の事象に係わる記述に関する注意：
- 本資料及び当社代表者が口頭にて提供する情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料における記述、及び当社代表者が口頭にて提供する情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

本日のご説明

01 自己紹介

02 会社概要

03 各事業の詳細

04 ありたい姿と経営計画

05 株主還元

自己紹介

代表取締役会長 吉田 均



座右の銘: 虚心坦懐

趣味: ゴルフ

茨城県生まれ、茨城県育ち

1983年 当社入社

2000年 精密測定機器部門 技術部門リーダー

2005年 取締役

2007年 計測社(精密測定機器部門) カンパニー長

2011年 代表取締役

2015年 代表取締役社長CEO

2022年 代表取締役会長CEO

2025年 代表取締役会長 (現任)

他：2010年～2016年	日本精密測定機器工業会	会長
2017年～2019年	同工業会	副会長
2020年～	同工業会	会長 (現職)
2026年～	公益社団法人 精密工学会	会長 (現職)

本日のご説明

01 自己紹介

02 会社概要

03 各事業の詳細

04 ありたい姿と経営計画

05 株主還元

当社の概要

会社商号	株式会社東京精密 (Tokyo Seimitsu Co., Ltd.)
事業内容	半導体製造装置と 精密計測機器の製造販売
設立	1949年3月28日
本社	東京都八王子市
連結子会社	国内6社、海外11社 (他 非連結・関係会社12社)、17か国で展開*
従業員数	約4,250名 (正社員合計人数、期間平均臨時従業員数合計)*
資本金	11,732百万円*

* 2025年12月31日時点

本社及び八王子工場(東京都)



飯能工場(埼玉県)



土浦工場(茨城県)



名古屋工場(愛知県)



コーポレートブランド

「Accretech」とは

世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆様とともに大きく成長していく

ACCRETE

「共生」

+

TECHNOLOGY

「技術」



当社のパーパス

東京精密のめざす姿

創業時から受け継ぐ「技術を突き詰め、技術革新を成し遂げる土壌」を継承し、世界中の技術・知恵・情報の融合で「夢のある未来」の実現を目指します

Purpose

パーパス

Vision

計測で未来を測り、半導体で未来を創る

➤ 東京精密は“夢のある未来”を築く一員であり続けます

Mission

- 世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創りだし、皆さまと共に大きく成長していく
- WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう

Value

- お客さま、株主の皆さま、サプライヤさま、従業員、地域社会、国際社会など全てのステークホルダーとの間でWIN-WINの関係を創りあげ、持続可能な社会の実現に向け積極的に役割を果たすとともに、企業価値の向上に努めます

企業文化

技術を突き詰め、
技術革新を成し遂げる土壌

コア技術

精密に測る力

コーポレートガバナンス

取締役会の独立性、客観性、多様性



吉田 均
代表取締役 会長



木村 龍一
代表取締役 社長CEO



伯耆田 貴浩
取締役
半導体社 執行役員カンパニー長

外国人



ロミ・ブラダン
取締役



秋本 伸治
取締役 監査等委員

独立社外取締役



高増 潔
社外取締役



森 重哉
社外取締役

女性



相良 由里子
社外取締役 監査等委員



川崎 素子
社外取締役 監査等委員



高山 清子
社外取締役 監査等委員

事業構成

精密計測機器事業と半導体製造装置の2つの事業セグメントで構成

精密計測機器事業

370億円



精密な機械部品の、
長さ/粗さ/丸さなどを
「精密に測る」機器

モノが設計通りにできて
いるかを確認する

半導体製造装置事業

1,134億円



ハイテク機器内の
半導体や電子部品を
「造る・検査する」装置

特に検査装置の
「プローバ」に強み



異なる2つの事業を持つ強み

“計測技術”を持つ唯一の半導体製造装置メーカー
技術シナジーでイノベーションを創出

- 半導体製造装置 “計測機器ビルトインモデル”
- 異なる需要の波を持つ事業を有することによる収益の安定化



半導体製造装置

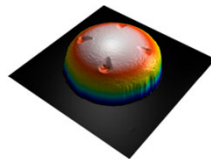


精密計測機器

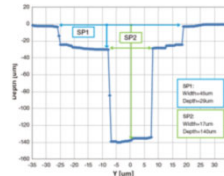


高精度な加工とリアルタイム測定の両立が可能

テスト後の針跡による
不良検知・判定

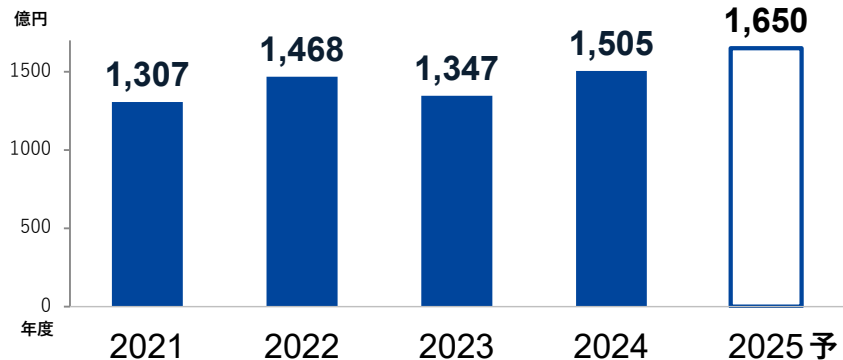


ハーフカット後の
断面形状評価

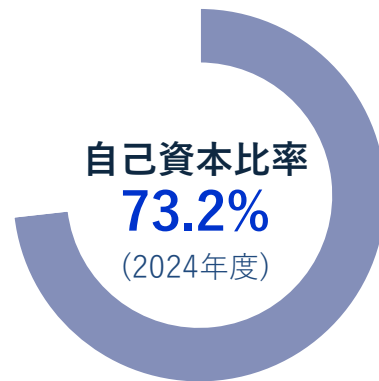
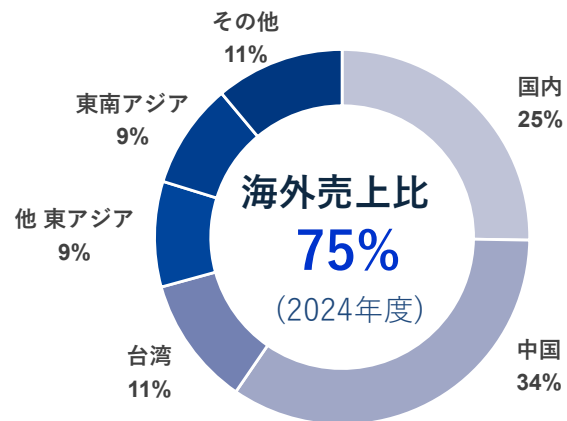
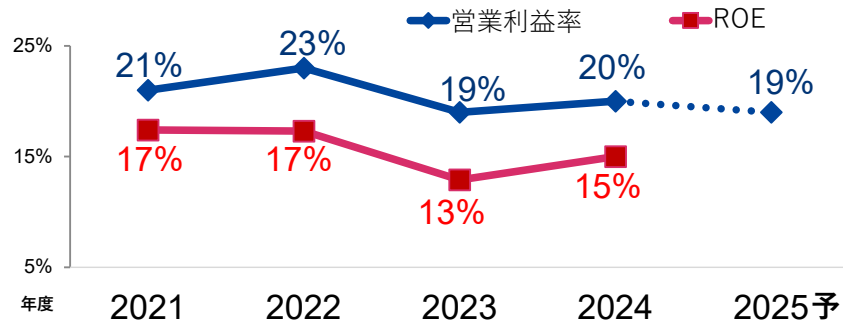


損益・財務ハイライト

売上高



営業利益率、ROE



本日のご説明

01 自己紹介

02 会社概要

03 各事業の詳細

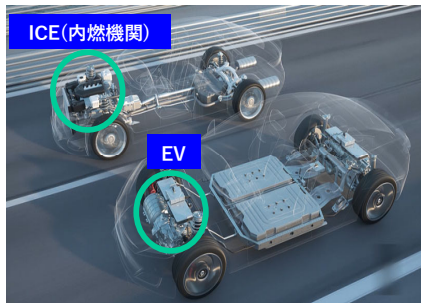
04 ありたい姿と経営計画

05 株主還元

精密計測機器事業

測れないものは作れない → 「長さ・粗さ・丸さ」などを測る機器群の事業

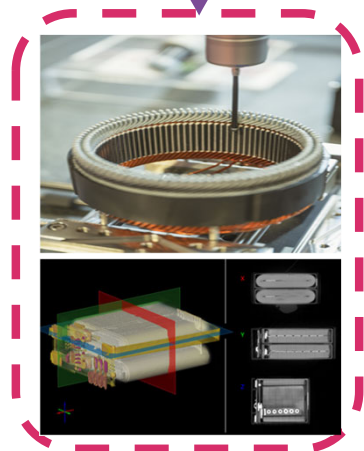
設計



製造



検査



精密計測機器による「確認」

完成



精密計測機器事業 当社の装置

長さを測る



三次元座標測定機

粗さを測る



粗さ・輪郭測定機

丸さを測る



真円度・円筒形状測定機

加工状態を測る



各種センサ

内部を測る



X線CT装置

電気の特性を測る



充放電試験システム

精密計測機器事業 分野別の売上高

自動車向けを中心に工作機械、航空機、半導体向けと幅広いものづくりに貢献

自動車・二輪

- モノづくり産業に占める自動車業界の割合自体が多い
- 部品の多くが性能に直結 (=高精度の計測が必要)



航空宇宙・防衛

- 大型部品の高精度測定

他 官公庁・金型など

機械・機械部品

- 工作機械・半導体・ロボット・医療機器・部品(ベアリング)など
- 内燃機関自動車系の需要減少を踏まえ、販売先の拡販を進めている



2024年度
計測事業
分野別売上高
(当社調べ)

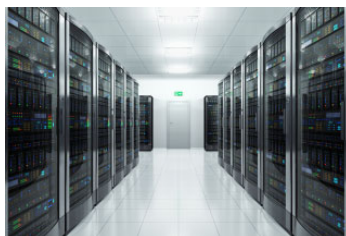
半導体製造装置事業

先端技術は、半導体デバイスや電子部品で作られている

当社はこれらを作るための装置(=半導体製造装置)を作っている



スマートフォン
パソコン



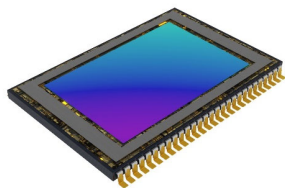
サーバー



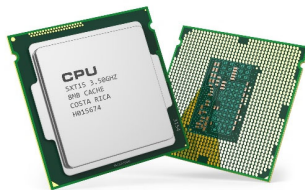
生成AI



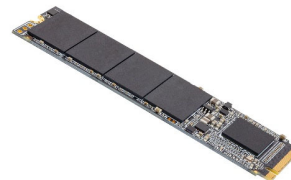
車載デバイス



画像センサー



ロジック半導体

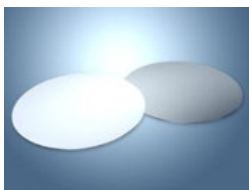


メモリ半導体

半導体製造装置事業 半導体の製造プロセス及び、当社の装置

半導体が作られる工程では、何百種類の製造装置が必要、当社は複数の装置を提供

ウェーハ
製造工程

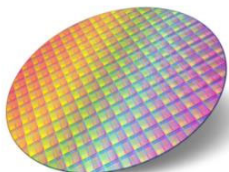


エッジ
グラインダ
ウェーハ壁面の研削加工

高剛性
研削盤
難削材ウェーハの研削加工



前工程
(配線形成)



CMP装置
配線表面の研磨加工



検査工程
(電気測定)



プロービングマシン
電気測定



後工程
(封止・組立)



ダイシング
マシン
チップの個片化

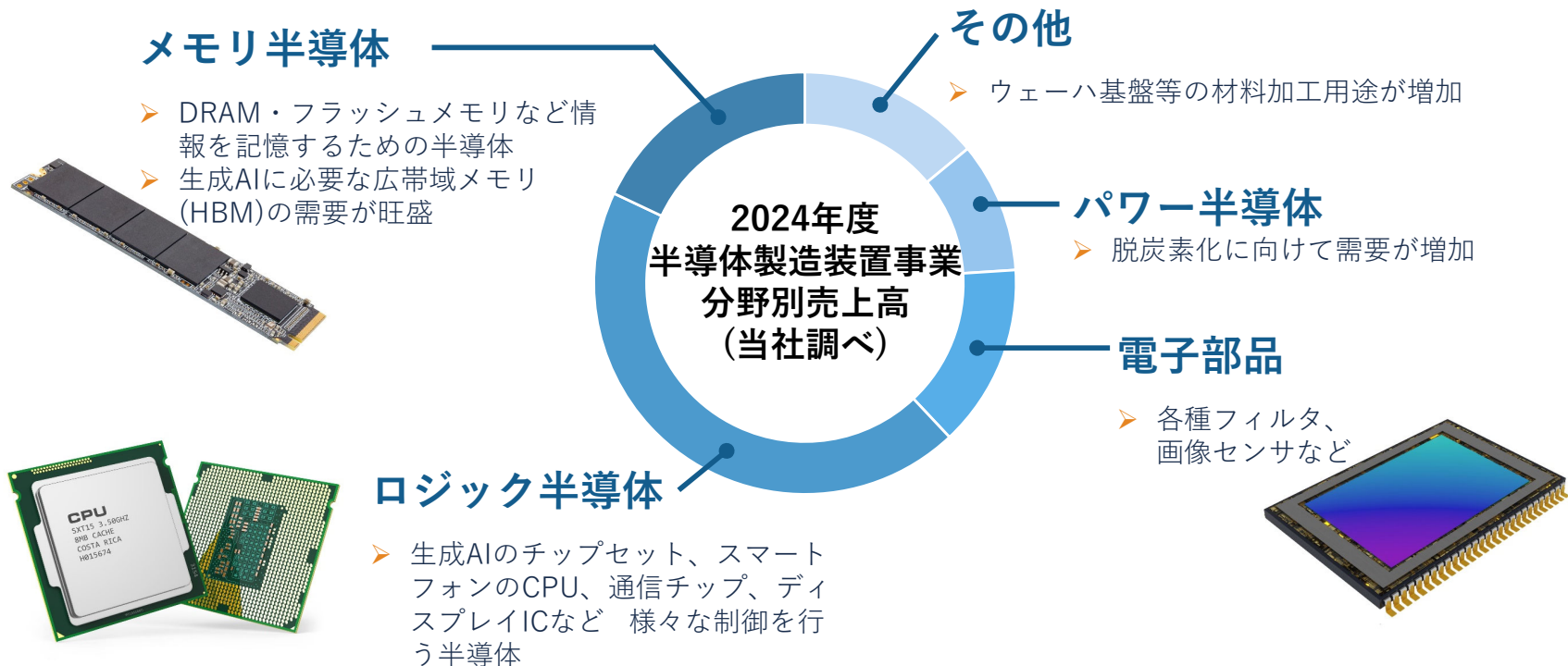


ポリッシュ
グラインダ
チップの薄片化



半導体製造装置事業 分野別の売上高

直近は、生成AIを含むHPC(High Performance Computing)向け需要がけん引



本日のご説明

01 自己紹介

02 会社概要

03 各事業の詳細

04 **ありたい姿と経営計画**

05 株主還元

東京精密グループ長期ビジョン2050

高度な技術力と豊かな創造性で
未体験の未来を切り拓く



革新的な半導体製造プロセスを実現する
最先端の製造装置を開発

各事業のありたい姿



“モノづくり革新”に欠かせない
精密測定機器・サービスの提供

今後10年で獲得・強化

新規事業創出に向けた研究・開発の強化

経営基盤強化

中期経営計画(2025-2027年度)の位置づけ

中期経営計画(2025-2027年度)では、「長期成長に向けた準備」と「期間の成長」とを両立する

2022
2024

年度(前回)

次の成長のための 布石置き

- 研究開発投資
- アプリケーション強化
- 生産キャパシティ拡張
- 環境投資

2025
2027

年度(今回)

持続的成長に向けた 足場固めとインフラ作り

- 戦略製品の成長促進
- 生産キャパシティ投資
- 計測・半導体のシナジー追求
- アプリケーション強化投資
- リカーリングビジネス強化
- 新事業創設への始動

~2035

年度(10年後)

当社製品・サービスがなければ 「モノを作れない・測れない」 絶対的なポジション確立

- 次世代・最先端デバイスに向けた高精度な加工・測定技術の提供
- シナジーが生み出す唯一無二の技術の確立
- 顧客のあらゆる課題に対するソリューションの提供

中期経営計画(2025-2027年度) 基本方針及び、定量目標

事業強化と事業基盤そのものの強化を両立させる

	2024年度 実績		中期経営計画期間 (2025-2027年度) 単年度
売上高	1,505億円 半導体1,135億円 計測371億円	約20%増加	1,850億円 半導体1,400億円 計測450億円
営業利益	297億円 半導体243億円 計測54億円	約50%増加	450億円
営業利益率	20% 半導体21% 計測15%	約4pt増加	24%
ROE	15%	高水準維持	15%

基本方針

- **戦略製品の成長促進**
半導体製造装置
 - 高付加価値製品・先端向け製品の強化計測機器
 - 充放電試験システムの強化
 - 高精度精密測定機の強化
- **計測・半導体の技術シナジー追求**
 - 精密計測機器をビルトインした半導体製造装置
 - 計測アプリケーションの半導体エリアへの応用
- **リカーリングビジネス強化**
 - 消耗品事業拡大、サービスビジネス強化

本日のご説明

01 自己紹介

02 会社概要

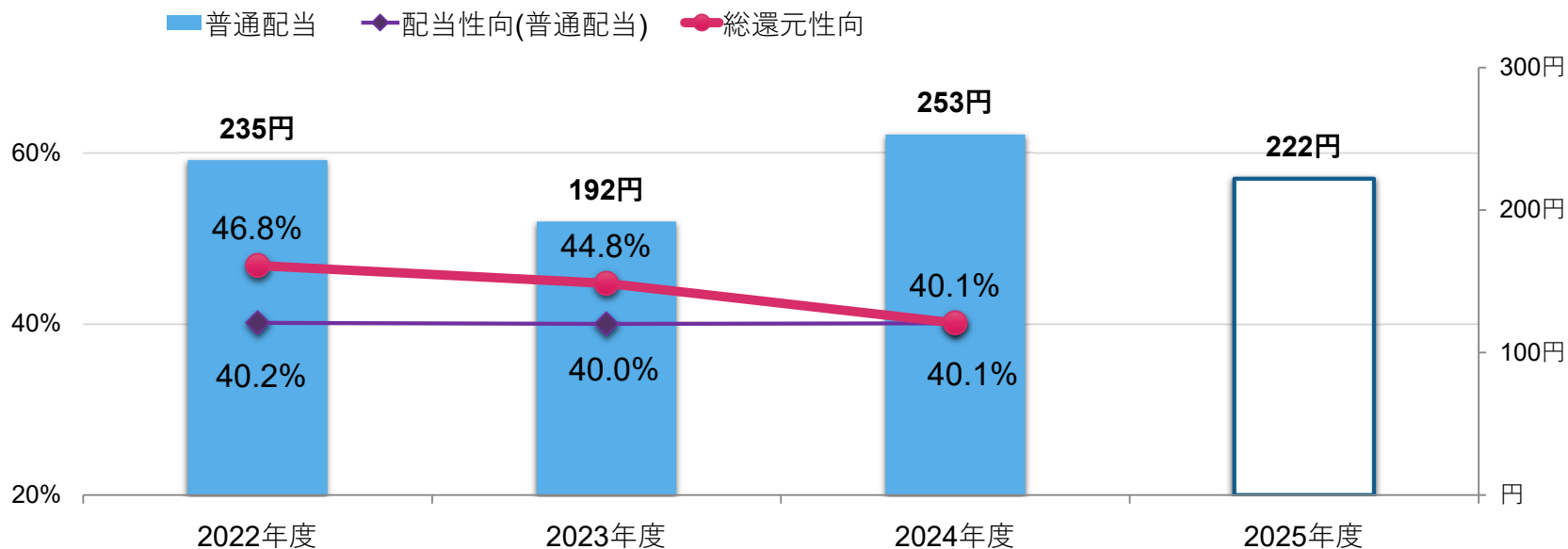
03 各事業の詳細

04 ありたい姿と経営計画

05 株主還元

株主還元

- 配当：業績連動の利益配分を基本に、連結配当性向40%程度を目安に実施
安定・継続的な配当観点から、利益水準に依らず、年20円配当は維持
- 自己株式取得：剰余金の配当を補完する機動的な利益還元策と位置づけ
2022年度、2033年度は自社株買いを実施



ウェブサイト、メール配信サービス



IRサイト

<https://www.accretech.com/jp/ir/index.html>



統合報告書サイト

https://www.accretech.com/jp/ir/integrated_report.html



メール配信サービス

<https://www.accretech.com/jp/ir/mail.html>



ご清聴ありがとうございました



<https://www.accretech.com/jp/>